



S100 导热粘接胶

产品特点

- **S100** 是一种双组份环氧类的功能性导热粘接胶，有着较高的导热效率和粘接力
- 材料基体稳定性高，导热性能衰减慢，满足热循环条件下的长期使用要求
- 电磁兼容性高，提高产品安规等级
- 非溶剂型，无挥发性，无铅、无卤、符合 UL 94V-0 标准
- 室温或低温加速固化，使电子电路免受生产过程中的高温影响而引起的性能衰减
- 适用于自动点胶、钢网印刷、手工涂抹等工艺，提高了产品的一致性
- 固化放热量少，收缩率低，满足精密器件的工艺要求，有较好的耐水性
- 广泛应用于光伏、LED、半导体及导热性能要求较高的模块等电子电器产品

常规性能

项目	SI00		测试方法或标准
外观&颜色	SI00A	白色胶体	目测
	SI00B	白色胶体	
粘度 cps@25°C	SI00A	12000~15000	Brookfield DV-3
	SI00B	12000~15000	
密度 g/cm³	SI00A	1.60	°C
	SI00B	1.52	
混合比例	A:B=1:1（重量比）		-
	A:B=1:1（体积比）		
固化条件	25°CX24h		-
	80°CX1h		
电阻率	≥2X10 ¹² Ω/cm²		厚度 10μm
剪切强度	20MPa		80X80mil 25°C
导热系数	6.5W/m•K		JESD51-14
操作时间	1~3 小时		15-35°C
保存期限	3 个月		< 25°C 密封避光
	12 个月		< 0°C 密封避光



操作说明

- 使用前请认真阅读本说明书或材料安全数据手册(MSDS)所包含的相关安全和健康信息,以确保安全使用
- 使用前确保元器件涂覆位置的清洁,保证表面无灰尘、油污、盐类及其它污染物,防止影响其导热及粘着性能
- 使用前首先将 A 料在原包装容器内搅拌均匀 (因为长期放置会出现沉淀), 按规定比例准确称取 A、B 组分, 混合后充分搅拌均匀 (A 和 B 有颜色差异, 混合至无颜色差异为止)
- 混合后的胶使用时间为 1-3 小时, 如超过使用时间, 胶液粘度会升高, 故每次配胶量不宜过多, 以免造成浪费; 如需要, 可将搅拌好的胶进行抽真空处理, 效果会更佳
- 导热胶的涂覆厚度不要超过 0.2mm, 否则会造成固化速度减慢、成本浪费和导热性能降低
- 不同季节由于温度变化, 固化速度会有所差异, 冬季温度低固化较慢, 该胶可采用加热的方式加速固化, 但温度不能高于 100°C
- 产品老化必须在完全固化之后进行, 否则极易造成因内应力过大而使光源脱落
因此, 严禁进行 2 次固化, 确保胶水经过 1 次受热后即完全固化

操作工具

- 自动点胶机
- 自动搅拌机
- 印刷或丝网钢网

储存说明

- 将 A、B 组分单独密闭冷冻储存于干燥、通风处

储存环境	保存期限
25°C 避光保存	3 个月
0°C 避光保存	12 个月

包装说明

- 管装: 最小包装 1000 克(A=500 克, B=500 克)
- 桶装: 最小包装 40 公斤(A=20 公斤, B=20 公斤)

*注: 以上性能数据仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到全部数据, 敬请客户使用时, 以实测数据为准